****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |



*Bryan Lin, General Manager bei congatec, leitet das Integrationssupport-Team in APAC.*

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Pressemitteilung

**COMPUTEX 2017: congatec macht seinen
persönlichen Integrationssupport global verfügbar**

**Premiumservice ist essentiell für hochwertige Produkte**

**Deggendorf, Deutschland, 23. Mai 2017 \* \* \*** congatec – ein führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer und Embedded Design & Manufacturing Services – gibt auf der COMPUTEX Taipeh (Stand J1224) die globale Verfügbarkeit seines persönlichen Integrationssupports für OEMs bekannt. Der persönliche Integrationssupport ist ein Premiumservice von congatec, um die Verwendung von Embedded Computertechnologie zu vereinfachen. OEM Kunden auf der ganzen Welt profitieren von einer Kontaktstelle für die Beantwortung all ihrer Fragen. Sie müssen nicht mehr in anonymen Warteschleifen warten oder haben ständig wechselnde Ansprechpartner. Stattdessen profitieren OEM Kunden weltweit von einem persönlichen Ansprechpartner für die Beantwortung all ihrer Design-In Fragen. Dieser im Embedded Markt einzigartige Premiumservice von congatec ist für Entwickler einfach, unkompliziert, sehr komfortabel und ohne Zusatzkosten global verfügbar.

„Unsere Ingenieure im globalen Integrationssupport kümmern sich persönlich um die Beantwortung von Kundenanfragen. Sie sind geschult, Entwicklungsingenieuren zu helfen, die Kosten- und Zeitaufwendungen ihrer Projekte signifikant zu reduzieren. Indem wir OEMs bei den Integrations-Herausforderungen unterstützen, helfen wir Ihnen gleichzeitig auch die Projektperformance ihrer Kunden zu verbessern und bauen eine starke und vertrauensvolle Beziehung auf, quasi einen gemeinschaftlichen Teamgeist. Wir glauben, dass solche Premiumservices ein Muss für Unternehmen in der High-Tech Embedded Industrie sind. Nicht nur, um eine möglichst schnelle und effiziente Time-to-Market zu erzielen, sondern auch für eine größtmögliche Kundenzufriedenheit“, erklärt Jason Carlson, CEO von congatec.

In China, Taiwan und anderen APAC-Staaten ist das 2015 eröffnete congatec Designcenter in Taipeh für den persönlichen Integrationssupport zuständig. Die Designcenter für Europa befinden sich in Deggendorf, Deutschland und Brünn, Tschechien. Das Designcenter für den amerikanischen Kontinent befindet sich in Boca Raton, Florida. Weitere Serviceteams für den persönlichen Integrationssupport befinden sich in Großbritannien, Frankreich, Japan und Australien. An all diesen Standorten erhalten Kunden einen Premium-Support für das Design-In neuester Produkte und Best-Practice Designs, die congatec auf der COMPUTEX präsentiert.

Ein Highlight der COMPUTEX Präsentation von congatec ist die Quick-Boot Demo auf Basis des congatec Qseven Computer-on-Moduls conga-UMX6 mit NXP (ehemals Freescale) i.MX6 Prozessoren. Mit dem extrem flexibel konfigurierbaren Quick-Boot können i.MX6 basierte Systeme innerhalb eines Sekundenbruchteils vom ausgeschalteten Zustand in den vollen Betrieb wechseln – inklusive laufender Applikationen. Das ist sehr wichtig für eine herausragende Nutzererfahrung bei maximaler Stromeinsparung. Typische Anwendungsfälle finden sich in Kiosksystemen und der Videoüberwachung mit Bewegungserkennung sowie in allen weiteren Applikationen, die bei Eingabe unmittelbar verfügbar sein müssen. Dazu zählen unter anderem auch Infotainment-Systeme in Fahrzeugen sowie HMIs und GUIs aller Art für die Maschinensteuerung.

Ebenfalls beeindruckend ist die neue SMARC 2.0 Demo auf Basis der Intel® Atom™, Celeron® und Pentium® Prozessoren (Codename Apollo Lake), mit der congatec die Implementierung eines vollständigen USB Typ C Ports inklusive USB 3.1, Power und Grafiksignalen zeigt. Durch eine solch universell einsetzbare Plug & Play Funktionalität vereinfacht congatec den Einsatz von Embedded Technologie signifikant. USB-C Buchsen mit vollem Funktionsumfang sind zwar noch selten, repräsentieren aber einen echten Durchbruch in der Standardisierung der fragmentierten Welt kabelgebundener externer Schnittstellen. Eine solche Standardisierung ist sowohl für Systementwickler als auch für Systemintegratoren, Administratoren und Gerätenutzer von großem Vorteil.

Ein Highlight für die High-End Embedded und Edge-Server Segmente sind die neuen COM Express Typ 7 basierten Server-on-Module. Sie bieten Serverperformance und Funktionalität mit ihren Intel® Xeon® D Prozessoren, 2x 10 GbE und 32 PCIe-Lanes, die für leistungsfähige Systemerweiterungen wie GPGPUs und NVMe basierte, ultraschnelle Speichermedien sowie Multimodul-Konfigurationen auf einem Carrierboard für HPC-Designs (High Performance Computing) genutzt werden können. Anwendungsfelder für Server-on-Module finden sich in unterschiedlichen Bereichen. Von IT- und carriergrade Serverfarmen über Cloudlets bis hin zu Edge-, Fog- und Industrie 4.0 Servern.

Außerdem zeigt congatec seine umfassende Produktpalette an Embedded Boards und Modulen auf Basis der neuesten Intel® Atom™, Celeron® und Pentium® Prozessoren (Codename Apollo Lake) sowie Intel® Core™ Prozessoren (Codename Kaby Lake). Sie bieten alle einen umfassenden Off-the-Shelf Treibersupport für unterschiedlichste Markt- und Kommunikationsanforderungen – inklusive Bargeld- und Zahlungsprotokoll-Support für Kiosksysteme. Dies ist einer der zahlreichen Vorteile, mit denen sich congatec von Boardlevelprodukten der Wettbewerber unterscheidet, die häufig keinen so umfassenden Footprint im Smart-Devices-Markt und Maschinenbau aufweisen.

Die Präsentation des neuen congatec Cloud-API (Application Programming Interface), das für IoT Gateways und Edge Server entwickelt wurde, rundet die Innovationen von congatec als einem der weltweit führenden Anbieter von Boards, Modulen und Embedded Design und Manufacturing Services ab. Die API soll als universeller Hub zwischen den lokalen Sensornetzwerken und den IoT-Clouds dienen. Dafür kommuniziert das neue congatec Cloud-API für IoT-Gateways vor Ort mit intelligenten Sensoren, verarbeitet und konvertiert die empfangenen Sensordaten und führt über die lokale Rule-Engine automatisierte Aktionen aus. Das reduziert den Datenverkehr zur IoT-Cloud und ermöglicht schnelle Reaktionen vor Ort. Für den sicheren bidirektionalen Datenaustausch mit jeder geeigneten Cloud sorgt das TLS gesicherte MQTT Protokoll. Clients können auf die Cloud im Admin oder User-Modus via https zugreifen. In der Summe machen diese Features das neue congatec Cloud-API für IoT-Gateways zum idealen Sprungbrett für OEMs, die auf intelligente Sensornetzwerke über IoT-Gateways und IoT-Edge-Server zugreifen wollen und dafür das umfassende Board- und Modul-Angebot von COM Express, Qseven und SMARC bis zu Pico-ITX und Mini-ITX Motherboards sowie verschiedene IoT-Gateway-Designs von congatec nutzen. Auch kundenspezifische Konfigurationen der congatec Cloud-API sind über die Embedded Design & Manufacturing Services (EDMS) von congatec möglich.

Weitere Informationen über die congatec Qseven Computer-on-Module mit Quick Boot finden Sie unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/qseven/conga-umx6.html>

Weitere Informationen über die neuen congatec SMARC 2.0 conga-SA5 Computer-on-Module finden Sie hier: <http://www.congatec.com/de/produkte/smarc/conga-sa5.html>

Weitere Informationen über die neuen congatec COM Express Typ 7 Server-on-Module finden Sie unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ7/conga-b7xd.html>

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in den USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel und Intel Atom, Celeron, Pentium, Core und Xeon sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*